

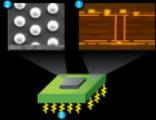
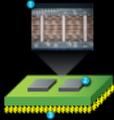
# FCBGA (Large Body)

## 개요

## OVERVIEW

대용량 Data, AI 기술로 MCP 가속화 및 High-End 제품 증가

- 고속 신호처리 대응을 위한 FCBGA 기판 고다층 & 대형화 가속

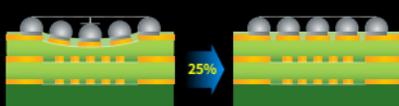
	① 크기, 층수	35mm X 35mm, 10층	<b>5배</b>	75mm X 75mm, 20층	
	② 범프 수	10,000 개	<b>8배</b>	80,000 개	
	③ 신호 Net 수	500 개	<b>8배</b>	4,000 개	
	④ 패키지 구조	 싱글층 패키지	 Si Interposer 패키지	 플립칩 패키지	

## 핵심 기술

## CORE TECHNOLOGY

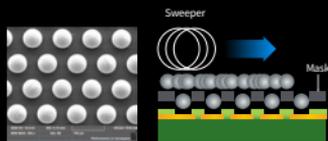
### 평탄도 제어

- 대면적 Cu / 절연층 두께 산포 제어



### 대면적 Bump 실장

- 고정합 실장 기술



[ Bump 수 : 80K ]

## 주요 사양

## KEY SPECIFICATIONS

기판 층수 / 크기	16~20층 / 75mm X 75mm
Core 두께	800 $\mu$ m ~ 1200 $\mu$ m
회로 (Line/Space)	12/12 $\mu$ m
Bump Pitch / Bump 수	130 $\mu$ m / 20K ~ 80K